苏州思迪科电子科技有限公司
苏州市吴中区田上江路 105 号苏豪工业园 A1 栋厂房 3 层
电话：86-512-68700225
传真：86-512-68700226

文件名称:SH49F ABS SOT-23-3 ASSEMBLY BUILD SHEET

批准日期:2016-6-7 文件编号: 第1页共2页

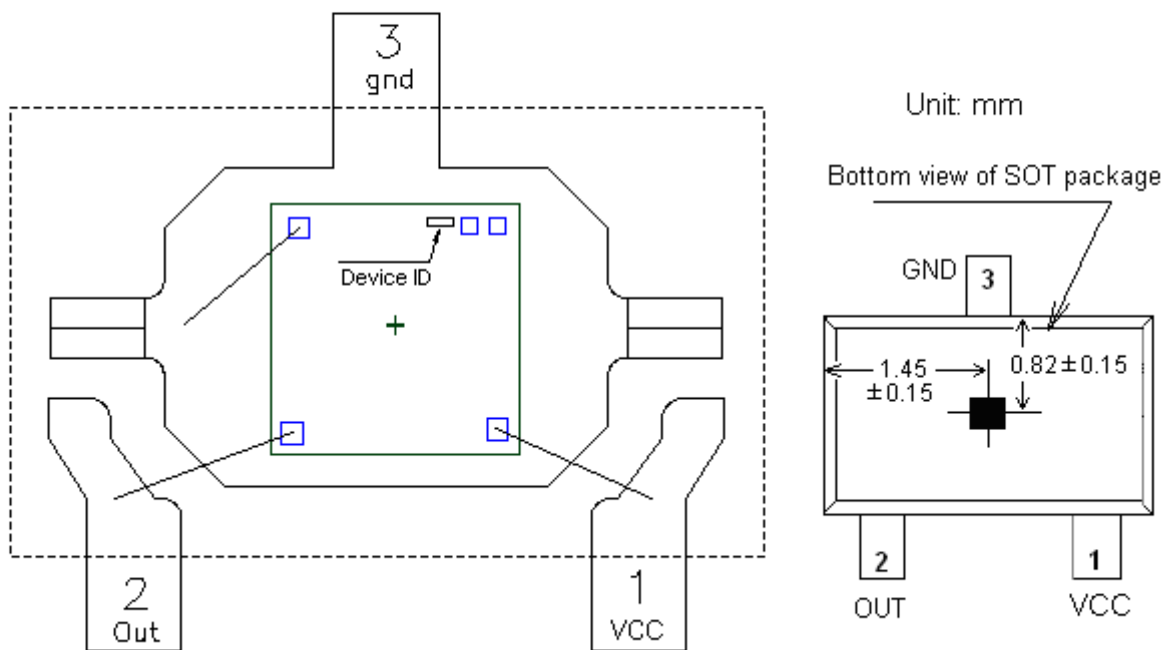
1.0 Updates

Version Released Dated 01 Jun 06, 2016

2.0 Build Sheet

Change The first version

Proposer JB Wang



注：先打接地线(pin3)

Part No.:	SH49F	Package Type - # Leads (Code):	SOT-23-3
Device No.:	PN102.1.3	Wafer Diameter:	6”
Bonding Pad Opening:	80*80 um2	Wafer thickness:	675um
Die Rev.:	1.3	Bonding Pitch:	N/A

苏州思迪科电子科技有限公司
苏州市吴中区田上江路 105 号苏豪工业园 A1 栋厂房 3 层
电话：86-512-68700225
传真：86-512-68700226

Die Size:	0.96*0.97 mm2	Scribe Line Width:	60um
Lead Frame Material/Finish	C194	Wire/Diameter	(4N)Φ0.8mil-Au 3wires
L/FSupplier	ASM	Wire Supplier	常熟贺利氏/宁波康强
Die Flag Size	51*72mil2	Mold Compound	EME-G600F
D/A Material	8290	Packing type	Tape reel
Plating	Lead Free	AL Thickness	1.2um

GT6YWW	49F	Marking ID (per Datasheet)	Arial/ Arial Narrow type font
	Comments: Laser Mark Only.		

苏州思迪科电子科技有限公司
苏州市吴中区田上江路 105 号苏豪工业园 A1 栋厂房 3 层
电话：86-512-68700225
传真：86-512-68700226

3.0 PAD diagram (外框包括划片道)

注:Hall sensor 中心到芯片左边距为 479um, 到下边距为 500um。 (见图中标尺)